

低交联密度导热凝胶 RH-TCG-0602 说明书

特色:

- 双组分（热）固化导热硅凝胶
- 高热稳定性，耐热冲击循环
- 低挥发分、低应力、低粘度、低 BLT，抗 pump out

产品组成

- 硅凝胶

产品应用

- 高导热高流速导热硅凝胶原料

常见性能参数

产品名称	RH-TCG-0602
固化温度, °C	120°C 加热
操作时间/固化时间	>2 h / <24 h
使用温度	-40-200 °C
适用填料量	96%
渗油率	小于 3%
1/4 锥 锥入度	10 mm ± 2
粘度 (A/B)	55 mpa·s ± 5/40 mpa·s ± 5
环体 (A:B=1:1)	<1300
粘度 (A:B=1:1)	50 mpa·s ± 5
双组份 96%填充量挤出速率	>8 g/min

应用方法

A 组分含有催化剂，B 组分含有抑制剂。

A/B 组分均含有偶联剂，除填料难以混开的条件下，配方中不建议额外添加偶联剂。

建议将硅油与 96%填料量的填料混合均匀后，置于 120 °C 固化 1 h。

运输储存条件

双组分包装:

- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存
- 最佳使用期限为 12 个月以内

其他注意事项

- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 配方配置时，需注意避免高温（80 摄氏度以上）
- 如需返工，再次使用前需清洁表面
- 注入胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触

低交联密度导热凝胶 RH-TCG-0602 说明书

特色:

- 双组分（热）固化导热硅凝胶
- 高热稳定性，耐热冲击循环
- 低挥发分、低应力、低粘度、低 BLT，抗 pump out

产品组成

- 硅凝胶

产品应用

- 高导热高流速导热硅凝胶原料

常见性能参数

产品名称	RH-TCG-0602	
固化温度, °C	120°C 加热	
操作时间/固化时间	>2 h / <24 h	
使用温度	-40-200 °C	
适用填料量	96%	
渗油率	小于 3%	
1/4 锥 锥入度	10 mm	10 mm ± 2
粘度 (A/B)	54.5/36.5 mpa·s	50 mpa·s ± 5/35 mpa·s ± 5
环体 (A:B=1:1)	657	<1300
挥发份 (A:B=1:1)	0.70%	<1.2%
粘度 (A:B=1:1)	-	40 mpa·s ± 5
双组份 96%填充量挤出速率	-	>8 g/min

应用方法

A 组分含有催化剂，B 组分含有抑制剂。

A/B 组分均含有偶联剂，除填料难以混开的条件下，配方中不建议额外添加偶联剂。

建议将硅油与 96%填料量的填料混合均匀后，置于 120 °C 固化 1 h。

运输储存条件
双组分包装:

- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存
- 最佳使用期限为 12 个月以内

其他注意事项

- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 配方配置时，需注意避免高温（80 摄氏度以上）
- 如需返工，再次使用前需清洁表面
- 注入胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触